



# 平成31年3月期 第2四半期決算短信(日本基準)(連結)

平成30年10月31日

上場会社名 丸文株式会社

上場取引所 東

コード番号 7537 URL <http://www.marubun.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 水野 象司

問合せ先責任者 (役職名) 経営企画部長 (氏名) 渋谷 敏弘

TEL 03-3639-3010

四半期報告書提出予定日 平成30年11月12日

配当支払開始予定日

平成30年12月4日

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有 (機関投資家・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

## 1. 平成31年3月期第2四半期の連結業績(平成30年4月1日～平成30年9月30日)

### (1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
31年3月期第2四半期	166,434	2.0	2,575	46.8	617	53.0	133	65.7
30年3月期第2四半期	169,875	33.0	1,753		1,314		390	

(注) 包括利益 31年3月期第2四半期 29百万円 (92.2%) 30年3月期第2四半期 381百万円 (%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
31年3月期第2四半期	5.12	
30年3月期第2四半期	14.93	

### (2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
31年3月期第2四半期	137,315	48,646	31.0
30年3月期	135,706	49,177	31.7

(参考) 自己資本 31年3月期第2四半期 42,549百万円 30年3月期 43,036百万円

## 2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
30年3月期		10.00		20.00	30.00
31年3月期		10.00			
31年3月期(予想)				20.00	30.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

## 3. 平成31年3月期の連結業績予想(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	325,000	6.5	5,800	53.8	3,450	18.2	1,800	13.4	68.87

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

連結業績予想の修正につきましては、本日公表いたしました「第2四半期業績予想と実績との差異および通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

## 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無  
新規 社 (社名) 、 除外 社 (社名)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

(注)詳細は、添付資料P.9「2.四半期連結財務諸表及び主な注記(4)四半期連結財務諸表に関する注記事項(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無

以外の会計方針の変更 : 無

会計上の見積りの変更 : 無

修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)

31年3月期2Q	28,051,200 株	30年3月期	28,051,200 株
----------	--------------	--------	--------------

期末自己株式数

31年3月期2Q	1,916,049 株	30年3月期	1,915,911 株
----------	-------------	--------	-------------

期中平均株式数(四半期累計)

31年3月期2Q	26,135,270 株	30年3月期2Q	26,135,373 株
----------	--------------	----------	--------------

四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

## 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(将来に関する記述等についてのご注意)

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、当社としてその事実を約束する趣旨のものではありません。実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料P.3「1.当四半期決算に関する定性的情報(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

## ○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
四半期連結損益計算書	
第2四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第2四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	8
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	9
(継続企業の前提に関する注記)	9
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	9
(当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動)	9
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	9
(追加情報)	9
(セグメント情報等)	10
(重要な後発事象)	11

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

## (1) 経営成績に関する説明

当第2四半期連結累計期間(平成30年4月1日～平成30年9月30日)におけるわが国の経済は、設備投資や生産が増加し企業収益や雇用情勢の改善が続いた一方で、米中の貿易摩擦による世界経済の下振れリスクや国内各地で発生した自然災害の影響などにより、先行きの不確実な状況が続きました。

当社グループが属するエレクトロニクス業界におきましては、自動車やデータセンター向けで市場拡大が継続した一方で、FA機器では中国市場を中心に需要が減少しました。また、MLCCなどの電子部品で需給ひっ迫が続いた一方で、DRAMやNANDフラッシュは需要が鈍化するなど、市場や品目によって好不調の入り混じった状況が続きました。

こうした状況の下、当第2四半期連結累計期間における当社グループの売上高は前年同期比2.0%減の166,434百万円となりました。利益面では、円高進行により前年度末に計上した外貨建て仕入・販売予定在庫の評価損を当年度戻し入れたことなどにより売上総利益が増加し、営業利益が前年同期比46.8%増の2,575百万円となりました。一方、当年度期初からの円安進行により、外貨建て債務の決済や評価などによる為替差損1,612百万円を計上したことから、経常利益は前年同期比53.0%減の617百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同期比65.7%減の133百万円となりました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

## (デバイス事業)

デバイス事業は、産業機器向け半導体の需要が増加し、自動車や通信機器向け半導体も堅調を維持した一方で、TVやPC向けメモリーICの売上が減少しました。その結果、売上高は前年同期比3.3%減の145,394百万円となりましたが、セグメント利益は、円高進行により前年度末に計上した外貨建て仕入・販売予定在庫の評価損を当年度戻し入れたことなどにより売上総利益が増加し、前年同期比125.9%増の2,187百万円となりました。

## (システム事業)

システム事業は、画像診断装置の売上が好調に推移し、電子部品実装機や組込み用コンピュータ、人工衛星向け高信頼性部品も需要が増加しました。その結果、売上高は前年同期比7.8%増の21,040百万円となりましたが、セグメント利益は販売費及び一般管理費の増加により前年同期比50.4%減の392百万円となりました。

## (2) 財政状態に関する説明

## (資産)

当第2四半期連結会計期間末における流動資産は123,569百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,271百万円増加いたしました。これは主に商品及び製品が6,942百万円減少した一方で、受取手形及び売掛金が4,921百万円、その他(短期貸付金)が2,271百万円それぞれ増加したことによるものであります。固定資産は13,746百万円となり、前連結会計年度末に比べ337百万円増加いたしました。これは主にのれんが56百万円減少した一方で、投資有価証券が401百万円増加したことによるものであります。

この結果、総資産は137,315百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,609百万円増加いたしました。

## (負債)

当第2四半期連結会計期間末における流動負債は78,220百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,455百万円増加いたしました。これは主に支払手形及び買掛金が1,886百万円、短期借入金が810百万円それぞれ増加したことによるものであります。固定負債は10,448百万円となり、前連結会計年度末に比べ315百万円減少いたしました。これは主に長期借入金が175百万円、退職給付に係る負債が113百万円それぞれ減少したことによるものであります。

この結果、負債合計は88,669百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,140百万円増加いたしました。

## (純資産)

当第2四半期連結会計期間末における純資産合計は48,646百万円となり、前連結会計年度末に比べ530百万円減少いたしました。これは主に利益剰余金が384百万円、為替換算調整勘定が227百万円それぞれ減少したことによるものであります。

この結果、自己資本比率は31.0%(前連結会計年度末は31.7%)となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成31年3月期の連結業績予想につきましては、平成30年5月8日に公表しました業績予想を修正いたしました。

平成31年3月期の売上高は、TV・PC向けメモリーICや産業機器向けアナログ半導体の減少を見込み、前期比6.5%減の325,000百万円となる見通しです。利益面では、円高進行により前年度末に計上した外貨建て仕入・販売予定在庫の評価損を当年度戻し入れたことなどにより売上総利益の増加を見込み、営業利益は前期比53.8%増の5,800百万円となる見通しです。一方、経常利益は上期に為替差損1,612百万円を計上したことなどにより、前期比18.2%減の3,450百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は前期比13.4%減の1,800百万円となる見通しです。

修正した内容の詳細につきましては、本日（平成30年10月31日）別途開示しました「第2四半期業績予想と実績との差異および通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

## 2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

## (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成30年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成30年9月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	13,989	14,196
受取手形及び売掛金	54,593	59,514
電子記録債権	6,227	6,659
商品及び製品	44,987	38,044
仕掛品	126	310
その他	2,386	4,860
貸倒引当金	△13	△17
流動資産合計	122,297	123,569
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	3,603	3,604
減価償却累計額	△2,252	△2,297
建物及び構築物（純額）	1,351	1,307
機械装置及び運搬具	10	10
減価償却累計額	△10	△10
機械装置及び運搬具（純額）	0	0
工具、器具及び備品	2,105	2,079
減価償却累計額	△1,645	△1,560
工具、器具及び備品（純額）	459	518
土地	1,618	1,618
リース資産	142	99
減価償却累計額	△94	△60
リース資産（純額）	48	38
建設仮勘定	52	66
有形固定資産合計	3,529	3,549
無形固定資産		
のれん	336	280
その他	1,264	1,416
無形固定資産合計	1,601	1,696
投資その他の資産		
投資有価証券	3,634	4,035
繰延税金資産	1,019	798
その他	4,080	4,105
貸倒引当金	△457	△439
投資その他の資産合計	8,277	8,499
固定資産合計	13,408	13,746
資産合計	135,706	137,315

（単位：百万円）

	前連結会計年度 (平成30年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成30年9月30日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	37,247	39,133
短期借入金	34,687	35,498
1年内返済予定の長期借入金	112	50
リース債務	34	32
未払法人税等	495	157
賞与引当金	1,044	1,040
資産除去債務	27	25
その他	2,114	2,282
流動負債合計	75,765	78,220
固定負債		
長期借入金	8,875	8,700
リース債務	62	47
退職給付に係る負債	1,388	1,274
役員退職慰労引当金	108	115
資産除去債務	175	177
その他	153	134
固定負債合計	10,763	10,448
負債合計	86,529	88,669
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	6,214	6,214
資本剰余金	6,353	6,353
利益剰余金	30,659	30,274
自己株式	△1,630	△1,630
株主資本合計	41,596	41,212
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	726	825
繰延ヘッジ損益	△29	28
為替換算調整勘定	678	451
退職給付に係る調整累計額	63	31
その他の包括利益累計額合計	1,439	1,337
非支配株主持分	6,140	6,096
純資産合計	49,177	48,646
負債純資産合計	135,706	137,315

## (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(第2四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成30年4月1日 至平成30年9月30日)
売上高	169,875	166,434
売上原価	159,603	155,052
売上総利益	10,272	11,382
販売費及び一般管理費	8,518	8,807
営業利益	1,753	2,575
営業外収益		
受取利息	34	29
受取配当金	26	26
持分法による投資利益	193	169
為替差益	6	—
雑収入	58	71
営業外収益合計	319	296
営業外費用		
支払利息	283	480
貸倒引当金繰入額	365	—
売上割引	73	52
為替差損	—	1,612
雑損失	35	109
営業外費用合計	757	2,254
経常利益	1,314	617
特別利益		
固定資産売却益	0	0
投資有価証券売却益	—	19
厚生年金基金解散損失引当金戻入益	—	3
特別利益合計	0	23
特別損失		
固定資産除売却損	32	4
投資有価証券評価損	171	—
特別退職金	—	11
その他	7	0
特別損失合計	211	17
税金等調整前四半期純利益	1,104	623
法人税等	467	344
四半期純利益	636	279
非支配株主に帰属する四半期純利益	246	145
親会社株主に帰属する四半期純利益	390	133



(四半期連結包括利益計算書)  
 (第2四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
四半期純利益	636	279
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	121	99
繰延ヘッジ損益	24	58
為替換算調整勘定	△366	△375
退職給付に係る調整額	△34	△31
持分法適用会社に対する持分相当額	—	0
その他の包括利益合計	△254	△249
四半期包括利益	381	29
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	285	36
非支配株主に係る四半期包括利益	96	△7

## (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成30年4月1日 至平成30年9月30日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前四半期純利益	1,104	623
減価償却費	199	228
のれん償却額	56	56
貸倒引当金の増減額(△は減少)	17	4
賞与引当金の増減額(△は減少)	△5	△3
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	4	6
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	△126	△158
受取利息及び受取配当金	△60	△55
支払利息	283	480
貸倒引当金繰入額	365	—
為替差損益(△は益)	356	1,976
持分法による投資損益(△は益)	△193	△169
固定資産除売却損益(△は益)	31	4
投資有価証券評価損益(△は益)	171	—
売上債権の増減額(△は増加)	△13,240	△5,135
たな卸資産の増減額(△は増加)	△4,000	6,695
仕入債務の増減額(△は減少)	2,340	1,882
その他	520	174
小計	△12,174	6,609
利息及び配当金の受取額	215	109
利息の支払額	△280	△456
法人税等の支払額	△441	△499
法人税等の還付額	9	2
営業活動によるキャッシュ・フロー	△12,672	5,765
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
定期預金の預入による支出	△262	△226
定期預金の払戻による収入	283	229
有価証券の取得による支出	△116	△22
有形固定資産の取得による支出	△118	△158
無形固定資産の取得による支出	△386	△355
投資有価証券の取得による支出	△11	△233
短期貸付けによる支出	—	△2,221
その他	52	38
投資活動によるキャッシュ・フロー	△557	△2,950
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の純増減額(△は減少)	17,158	△1,416
長期借入金の返済による支出	△56	△238
配当金の支払額	△391	△522
非支配株主への配当金の支払額	△132	△37
その他	△12	△9
財務活動によるキャッシュ・フロー	16,564	△2,225
現金及び現金同等物に係る換算差額	△19	17
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	3,316	607
現金及び現金同等物の期首残高	12,216	13,715
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	△43	△384
現金及び現金同等物の四半期末残高	15,489	13,937

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動)

該当事項はありません。

なお、特定子会社の異動には該当しておりませんが、前連結会計年度末まで連結の範囲に含めておりました Marubun Semicon (S) Pte.Ltd. は、清算手続き中であり重要性が低下したため、第1四半期連結会計期間より連結の範囲から除外しております。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

税金費用については、当第2四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。

なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。

(追加情報)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）等を第1四半期会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。

(セグメント情報等)

## 【セグメント情報】

## I 前第2四半期連結累計期間（自平成29年4月1日 至平成29年9月30日）

## 1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント			調整額 (注) 1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 2
	デバイス 事業	システム 事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	150,361	19,513	169,875	—	169,875
セグメント間の内部売上高 又は振替高	0	314	314	△314	—
計	150,362	19,827	170,189	△314	169,875
セグメント利益	968	790	1,759	△5	1,753

(注) 1. セグメント利益の調整額△5百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△5百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない投資不動産に係る費用であります。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

## 2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

## II 当第2四半期連結累計期間（自平成30年4月1日 至平成30年9月30日）

## 1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント			調整額 (注) 1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 2
	デバイス 事業	システム 事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	145,394	21,040	166,434	—	166,434
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	294	294	△294	—
計	145,394	21,335	166,729	△294	166,434
セグメント利益	2,187	392	2,579	△4	2,575

(注) 1. セグメント利益の調整額△4百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△4百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない投資不動産に係る費用であります。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

## 2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

## （重要な後発事象）

## （連結子会社の吸収合併）

当社は平成30年5月8日開催の取締役会決議に基づき、平成30年10月1日付で当社の完全子会社である株式会社ケイティーエルを吸収合併しました。

## 1. 取引の概要

## (1) 結合当事企業の名称及び事業の内容

企業の名称 株式会社ケイティーエル

事業の内容 電子部品等の販売

## (2) 企業結合日

平成30年10月1日

## (3) 企業結合の法定形式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社ケイティーエルは解散しました。

## (4) 吸収合併に係る割当ての内容

当社は株式会社ケイティーエルの発行済株式のすべてを所有しているため、本合併に際し、株式その他の金銭等の割当てはありません。

## (5) 引継資産・負債の状況

当社は、合併効力発生日に株式会社ケイティーエルの一切の資産、負債及びその他の権利義務を承継しております。

## (6) その他取引の概要に関する事項

当社グループにおける販売体制の強化と効率的な経営体制の構築を図るものであります。

## 2. 実施する会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年9月13日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日）に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行っております。

## （重要な事業の譲渡）

当社は平成30年5月8日開催の取締役会決議に基づき、平成30年10月1日付で当社の完全子会社である丸文セミコン株式会社が営む日本サムスン株式会社の販売特約店事業を株式会社トーメンデバイスに譲渡しました。

## 1. 譲渡する相手会社の名称

株式会社トーメンデバイス

## 2. 譲渡の時期

平成30年10月1日

## 3. 事業譲渡の概要

## (1) 譲渡する事業の内容

丸文セミコン株式会社が営む日本サムスン株式会社の販売特約店事業

## (2) 譲渡する事業の経営成績

前連結会計年度の連結損益計算書に含まれる当該事業の売上高 28,420百万円

## (3) 譲渡する資産、負債の額

現時点では確定しておりません。

## (4) 譲渡価額及び決済方法

現時点では確定しておりません。

## 4. 譲渡する事業が含まれている報告セグメントの名称

デバイス事業